

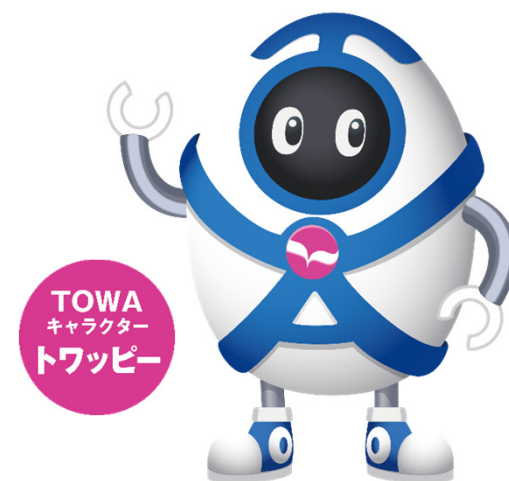


2024年3月期

# 決算説明資料

2024年5月10日

[Click here for the English Ver](#)



**TOWA株式会社**

# 主な説明内容

1. 2024年3月期 実績
2. 2025年3月期 予想
3. TOPICS

# 主な説明内容

- 1. 2024年3月期 実績**
2. 2025年3月期 予想
3. TOPICS

# 2024年3月期 サマリー

受注高

**527.1** 億円

売上高

**504.7** 億円

営業利益

**86.6** 億円

経常利益

**90.7** 億円

当期純利益

**64.4** 億円

## ▶ 受注高は前期比で+20.6%

受注高は生成AI関連向け投資や中国での半導体内製化に向けた投資の増加、その他アジア地域での車載用半導体やパワー半導体向け投資継続により、前期比で+20.6%と回復。

## ▶ 当社独自のコンプレッション装置・金型の受注・売上がともに過去最高

生成AI関連向け投資や中国での通信デバイス関連向け投資の増加により、当社独自のコンプレッション装置・金型の受注・売上ともに通期で過去最高を更新。

## ▶ 前期比で減収減益となるものの、各段階利益は予想を上回る

民生品向け需要の低迷により、前期比で減収減益となるものの、生成AI関連向けコンプレッション装置の売上増加などによる製品ミックスの改善により、各段階利益は予想を上回る。

# 2024年3月期 連結業績結果

(単位：億円)

	2023/3期 実績	2024/3期 予想	2024/3期 実績	増減	
				前期比	予想比
売上高	538.2	510.0	504.7	▲ 33.5 (▲ 6.2%)	▲ 5.2 (▲ 1.0%)
営業利益	100.3	81.6	86.6	▲ 13.7 (▲ 13.7%)	+ 5.0 (+ 6.1%)
営業利益率	18.6%	16.0%	17.2%	▲ 1.4pt	+ 1.2pt
経常利益	102.0	81.6	90.7	▲ 11.2 (▲ 11.0%)	+ 9.1 (+ 11.3%)
当期純利益	73.4	57.1	64.4	▲ 9.0 (▲ 12.3%)	+ 7.3 (+ 12.9%)

※当期純利益 = 親会社株主に帰属する当期純利益

# 2024年3月期 セグメント別売上高

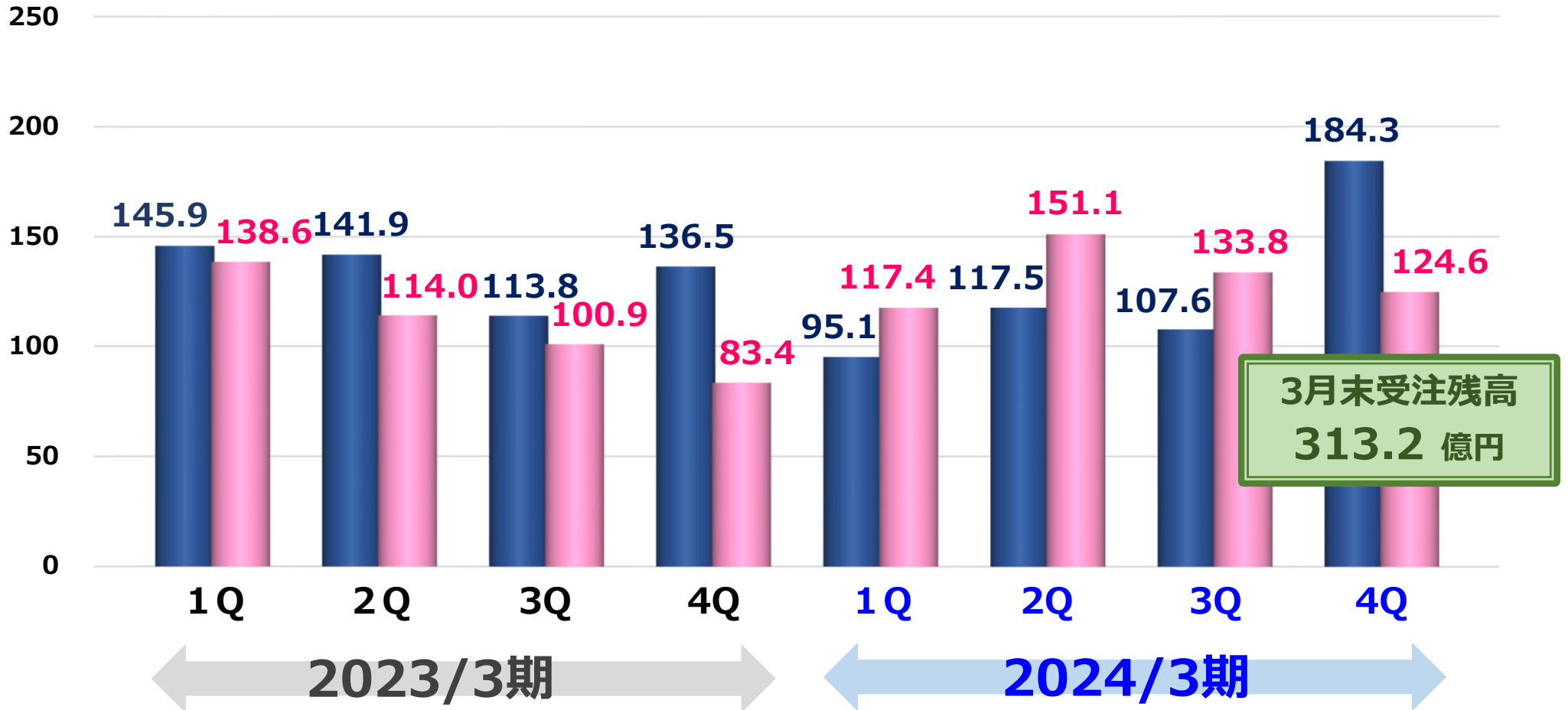
(単位：億円)

	2023/3期 実績	2024/3期 予想	2024/3期 実績	増減	
				前期比	予想比
売上高	538.2	510.0	504.7	▲ 33.5 (▲ 6.2%)	▲ 5.2 (▲ 1.0%)
半導体事業	412.6	370.6	383.2	▲ 29.4 (▲ 7.1%)	+ 12.6 (+ 3.4%)
化成品事業	19.5	20.0	21.5	+ 2.0 (+ 10.3%)	+ 1.5 (+ 7.5%)
新事業	80.1	93.4	75.8	▲ 4.3 (▲ 5.5%)	▲ 17.6 (▲ 18.9%)
レーザ事業	25.8	26.0	24.2	▲ 1.6 (▲ 6.6%)	▲ 1.8 (▲ 7.0%)

# 受注・売上高の推移

(単位：億円)

■ 売上高 ■ 受注高

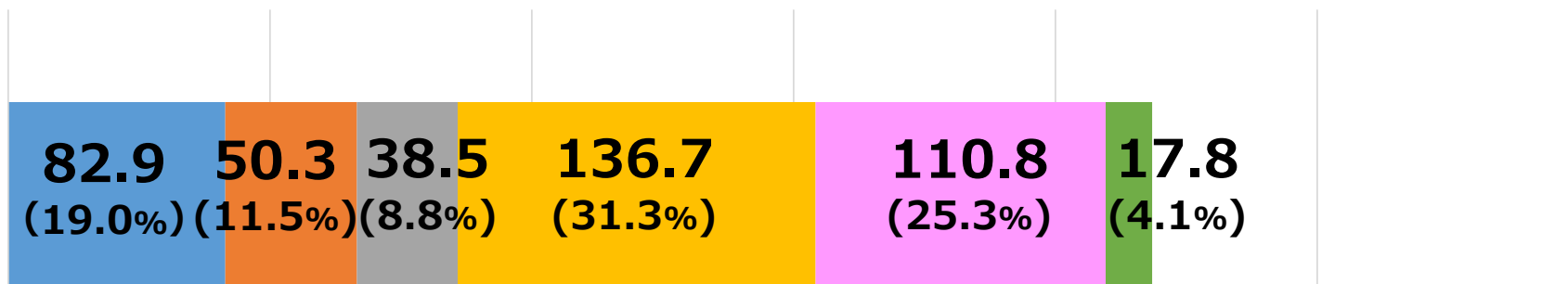


# 地域別受注構成比率（仕向地ベース）

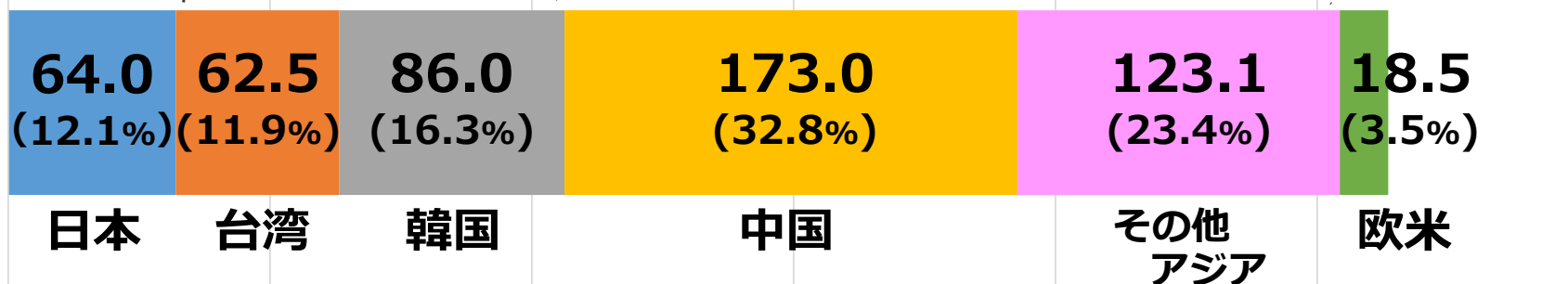
(単位：億円)

0.0 100.0 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0

2023/3期  
(通期)



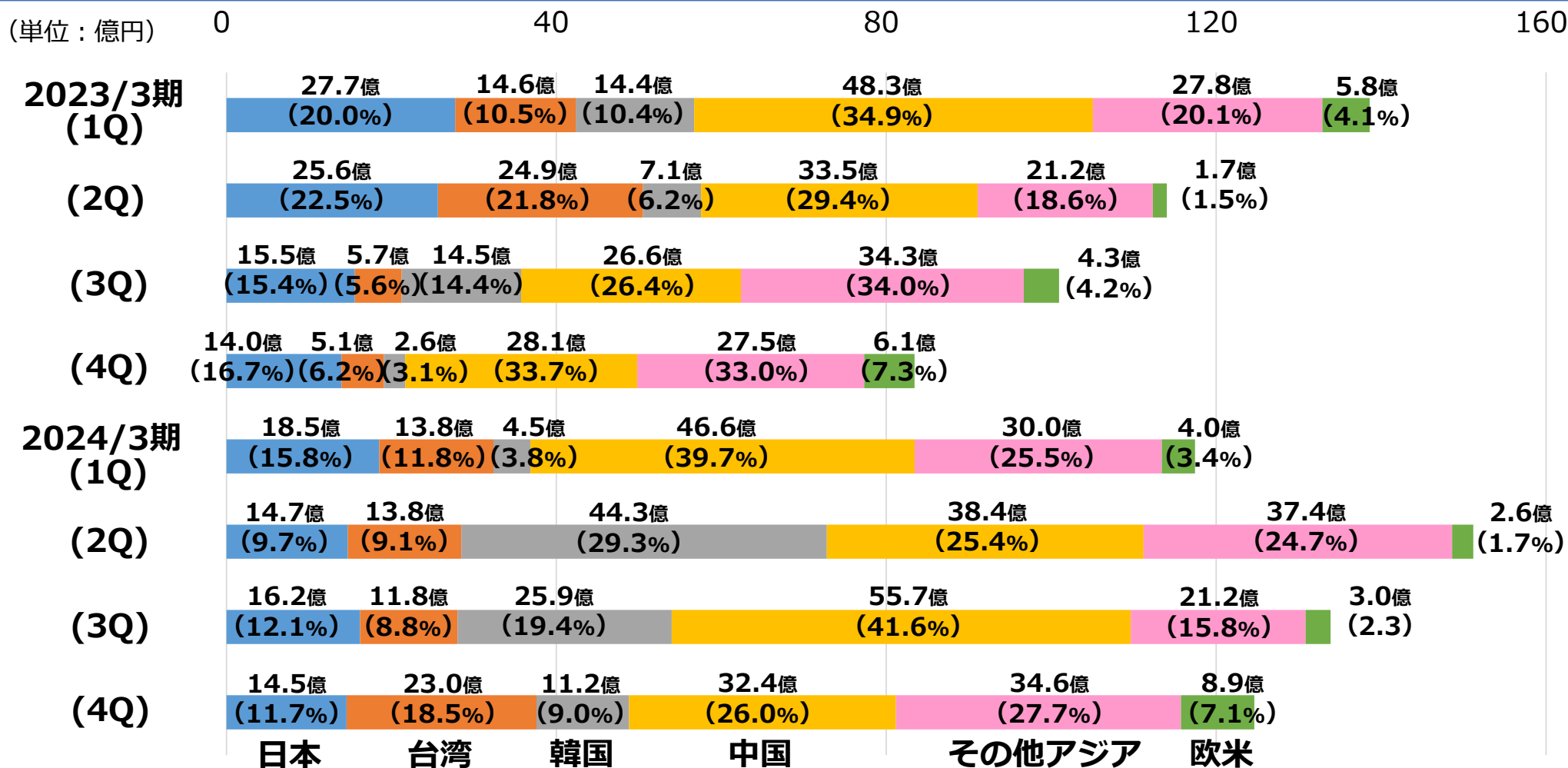
2024/3期  
(通期)





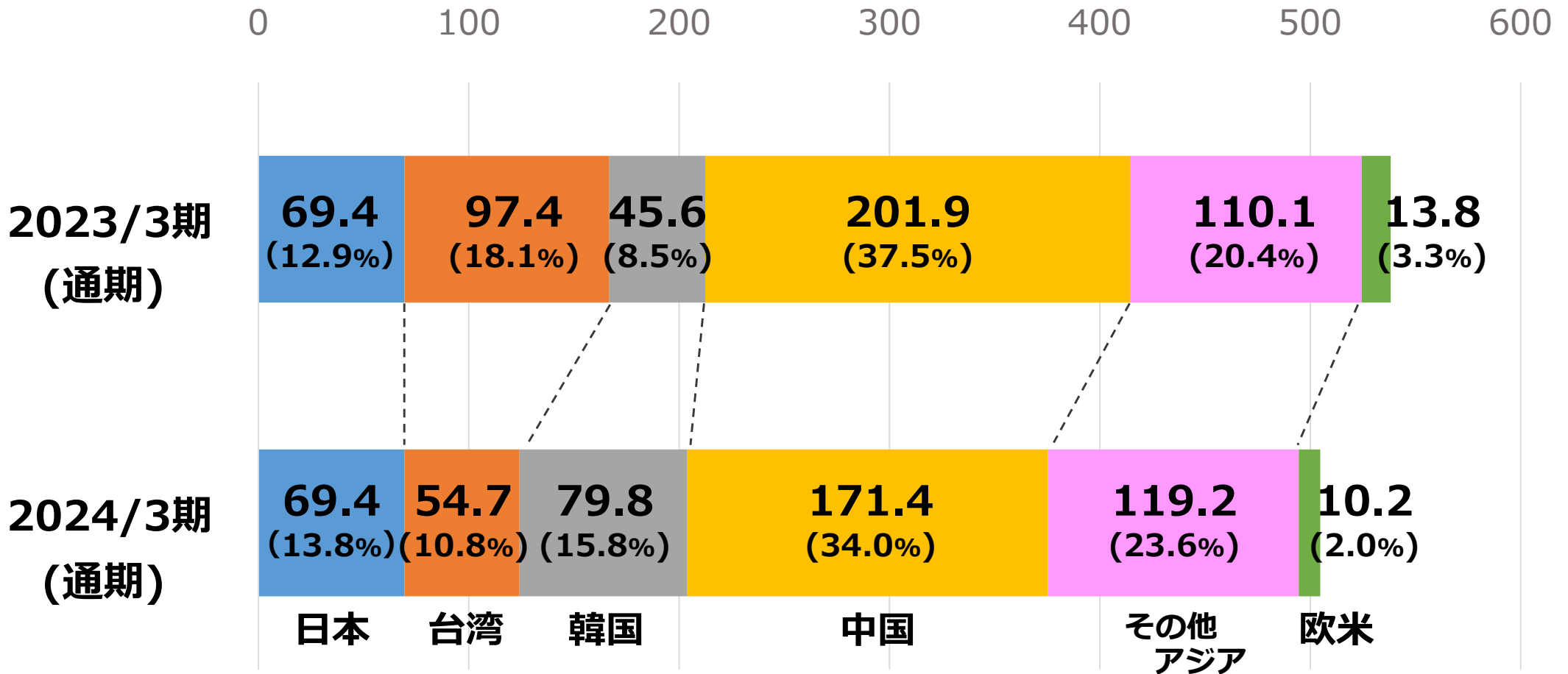
# 地域別受注構成比率推移（仕向地ベース）

(単位：億円)



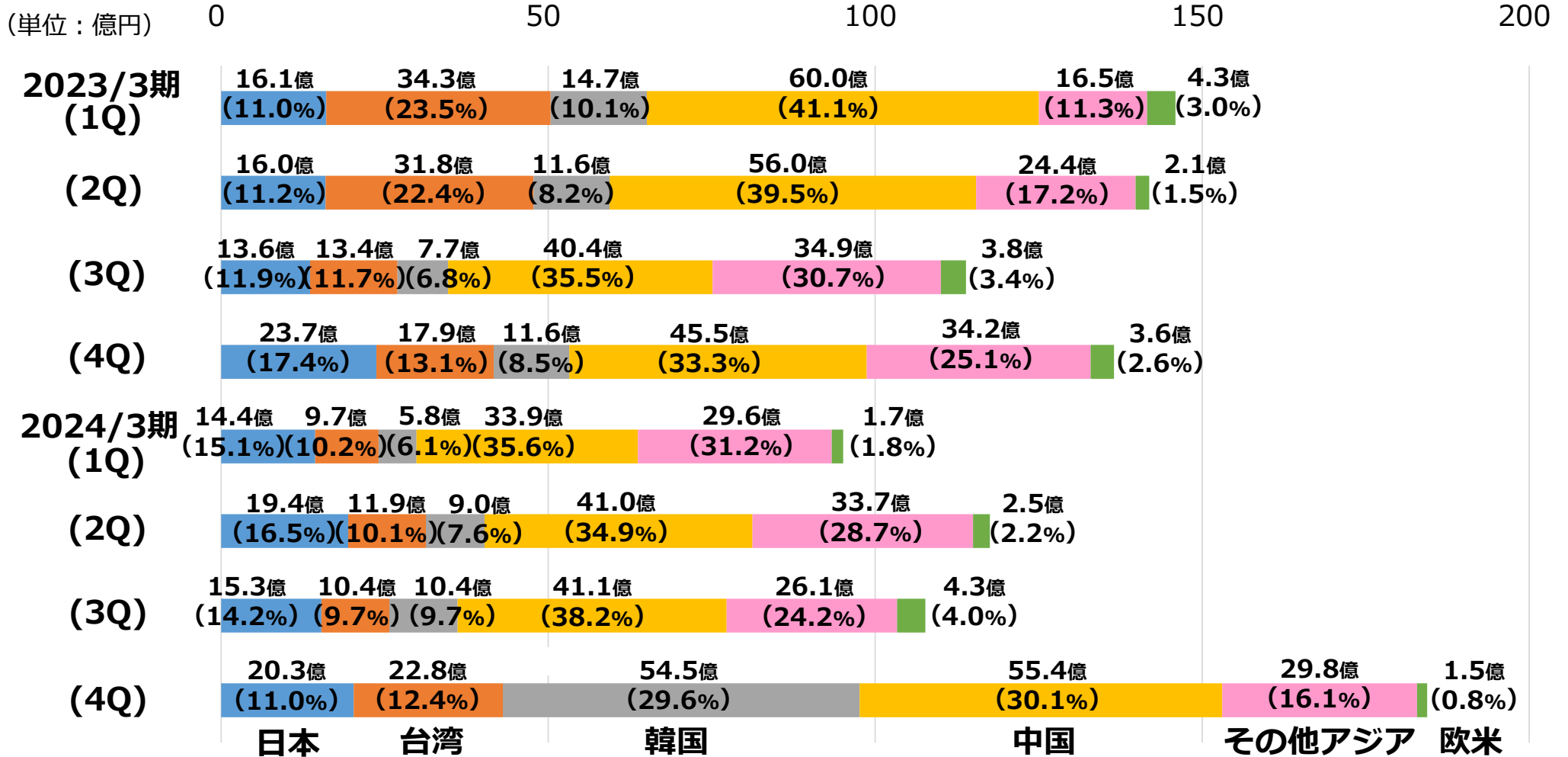
# 地域別売上構成比率（仕向地ベース）

（単位：億円）



# 地域別売上構成比率推移（仕向地ベース）

(単位：億円)



# 2024年3月期累計 連結営業利益 増減要因分析（対前年同期比）

（単位：百万円）

売上 53,822

売上 50,471

売上総利益への影響額  $\Delta 610$

10,037

$\Delta 1,439$

2,000

$\Delta 1,171$

$\Delta 765$

8,661

売上高の減少  
による影響額

製品ミックスや  
販売単価上昇など  
による影響額

評価損の発生及び  
製造原価に含まれる  
開発費の増加など  
による影響額

販売管理費の増加  
による影響額

'23/3期累計

営業利益(1,375百万円減)

'24/3期累計

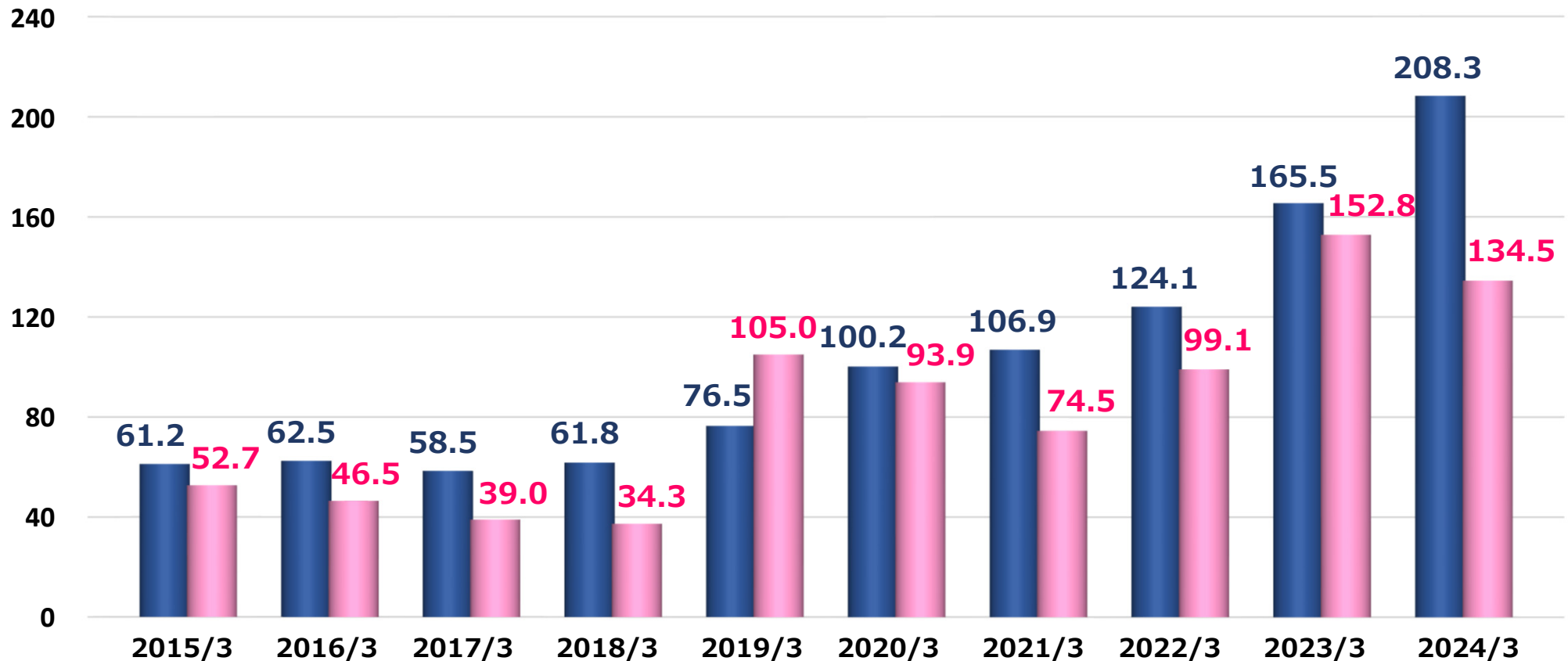
※百万円未満切り捨て

# キャッシュ・フローの推移

■ 現預金残高

■ 借入金残高

(単位：億円)



第一次中期経営計画

# 主な説明内容

1. 2024年3月期 実績
2. 2025年3月期 予想
3. TOPICS

# 2025年3月期 通期 連結業績予想

(単位：億円)

	2024/3期 実績	2025/3期 予想	増減額	前期比
売上高	504.7	600.0	+ 95.2	+ 18.9%
営業利益	86.6	126.0	+ 39.3	+ 45.5%
営業利益率	17.2%	21.0%	—	+ 3.8pt
経常利益	90.7	126.0	+ 35.2	+ 38.8%
当期純利益	64.4	88.3	+ 23.8	+ 37.0%

※当期純利益 = 親会社株主に帰属する当期純利益

# 2025年3月期 セグメント別売上予想

(単位：億円)

	2024/3期 実績	2025/3期 予想	増減額	前期比
売上高	504.7	600.0	+ 95.2	+ 18.9%
半導体事業	383.2	443.0	+ 59.8	+ 15.6%
化成品事業	21.5	22.0	+ 0.5	+ 2.3%
新事業	75.8	104.0	+ 28.2	+ 37.2%
レーザ事業	24.2	31.0	+ 6.8	+ 28.3%



# 設備投資・配当予想

	2024/3期 実績	2025/3期 予想
設備投資	20.0億円	60.0億円
配当	40.0円	60.0円

## ▶ 主な設備投資予定

- ・ 韓国新工場
  - ・ スマートファクトリー関連
  - ・ 各工場における新規生産設備導入や更新による生産能力UP
  - ・ 各拠点ラボ機能拡充
  - ・ 化成品事業拡大に向けた投資
- ◆ その他M&A等は積極的に実施

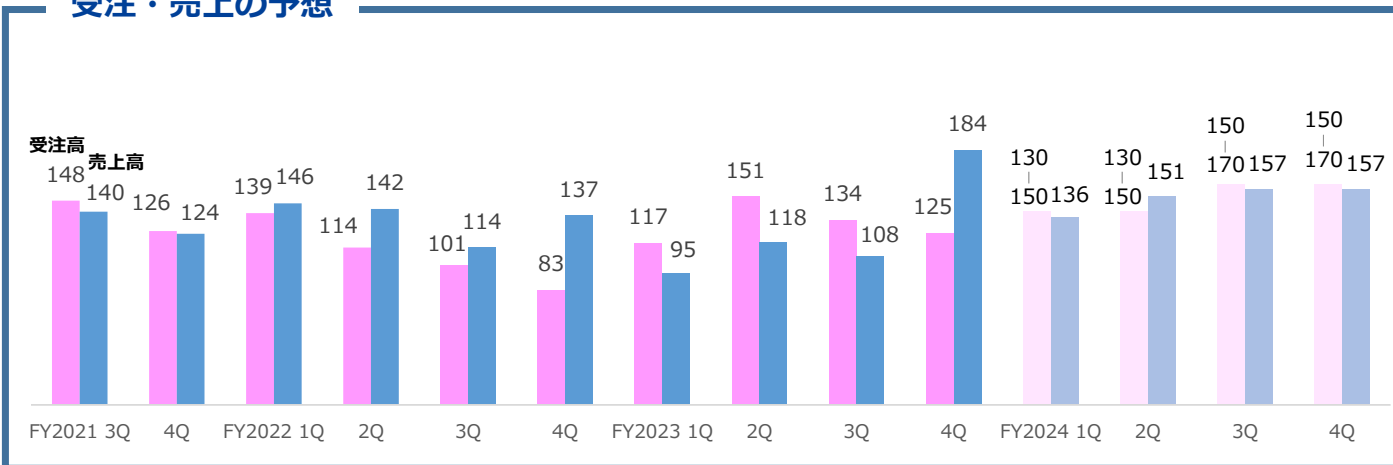
※配当方針「安定・継続配当」に基づき、20円増配の60.0円を計画しています。

# 市場見通し

## 今期の市場見通し

- 生成AI関連の投資は今期も活発に行われる見通し
- 中国での半導体内製化に向けた積極的な投資は今期も継続を見込む
- OSATの稼働率は改善してきており、設備投資も2Q頃から徐々に回復すると予想し、当社売上についても2Q頃から上昇を見込む。

受注・売上の予想



## 受注高予想

1Q	2Q
130-150億円	130-150億円
3Q	4Q
150-170億円	150-170億円

## 損益予想

売上高	600.0億円
営業利益	126.0億円
経常利益	126.0億円
当期利益	88.3億円

# 主な説明内容

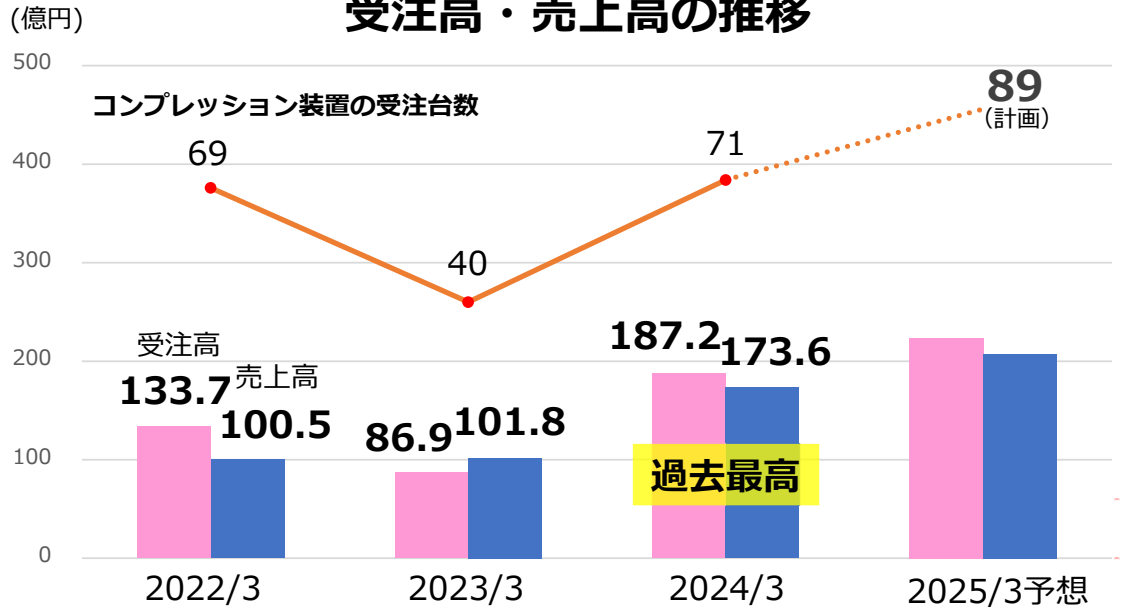
1. 2024年3月期 実績
2. 2025年3月期 予想
3. TOPICS

# TOWA独自のコンプレッション装置

## コンプレッション装置の受注・売上高が過去最高を更新!!

生成AI関連向けなど先端パッケージ向けを中心にコンプレッション装置の受注・売上高が大幅に増加!

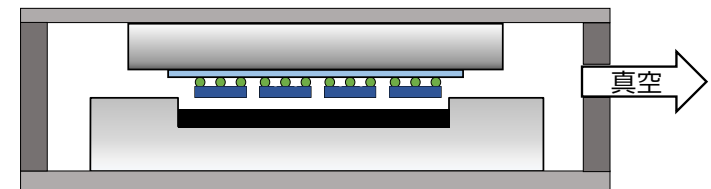
### コンプレッション装置※ 受注高・売上高の推移



※装置・金型含む

### 独自のキャビティダウン構造

- 独自のキャビティダウン方式により、素早く、高い真空度を実現し、高精度の狭ギャップ成形を実現!



### コンプレッション技術の活用が期待される分野

- 生成AI
- 次世代AIスマホ
- 自動運転
- ウェハーレベルパッケージ
- パネルレベルパッケージ
- 2.5D、3Dパッケージ

# 生産体制強化の取り組み

生産性向上に向けた取組強化と新たな生産拠点確保により、  
売上高1,000億円に向けた生産体制の早期構築を目指す。

## 金型工場のスマートファクトリー化



## 新たな工場スペースの検討



# 韓国での工場取得

売上高1,000億円達成に向けて、先端半導体投資の拡大が期待される韓国で工場を取得！



所在地	忠清南道天安市西北区車岩棟 425 (現韓国工場より車で約6分)
敷地面積	約16,137㎡
延床面積	約6,215㎡
取得日	2024年4月29日
用途	半導体製造装置組立、装置リニューアル、ラボ

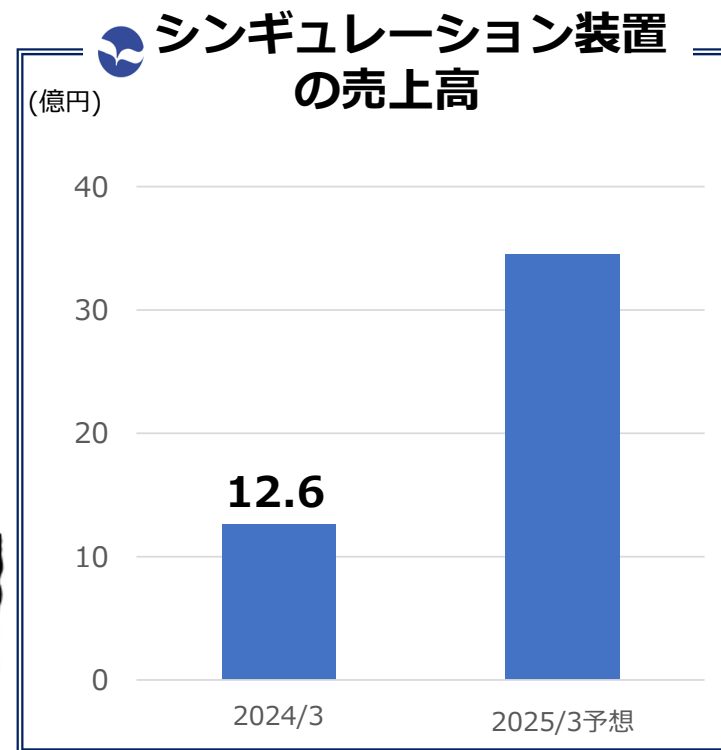
- ▶ 既存建物を活用することで早期生産立ち上げが可能であり、2Q頃からの稼働開始を目指す。
- ▶ 先端半導体向けモールドング装置需要の拡大が期待できる韓国において生産体制強化し、生産能力拡大と納期短縮を目指す。
- ▶ 装置リニューアルビジネスやラボ機能の拡充により、事業規模拡大を目指す。



# シンギュレーション事業強化

## 事業本部体制に移行し、開発・営業力を強化

- ▶ 2023年10月から開発・生産・営業部隊を備えた事業本部体制に移行し、市況回復と同時にシェア拡大に向けて、取組を強化。
- ▶ 最新機種「FMS4040」に加え、レーザ事業との開発連携を強化し、コラボ製品の早期市場投入を目指す。



# TOWA Technology Exhibition

## 先端パッケージにおけるTOWAの優位性をアピール



日程	2023年12月～2024年1月
来場社数	約140社
来場者数	約400名

### 後工程を取り巻く状況

- ・ 前工程での微細化に限界が見え、後工程で性能を高める動きが活発化
- ・ 半導体メーカー各社による「3次元実装」や「チップレット」等の先端パッケージ技術の開発や設備投資計画が増加

### お客様の声

- ・ 装置コンセプトが明確であり技術的優位性が高い
- ・ チップレット向けの新製品に非常に興味がある
- ・ コンプレッション技術はMUF\*製品に有効であり、前向きに検討したい

\*MUF(Mold Under Fill) : チップ下の狭ギャップ間への樹脂充填とチップ全体の封止を一括で行う技術

▶ 後工程の重要度が高まる中で、TOWAの先端技術に高い関心と評価



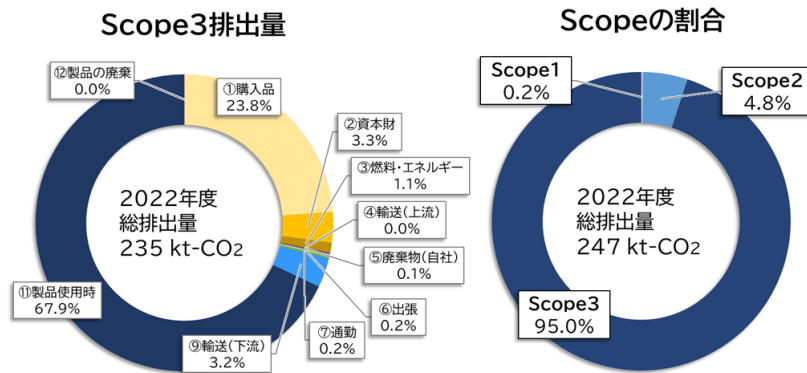
# ESGの取り組み

## Scope3排出量の算定

脱炭素の取り組みとして進めていたScope3排出量算定が完了し、当社ホームページにてデータを開示いたしました。

Scope1およびScope2につきましては、既に削減目標を定め、カーボンニュートラルを目指した取り組みを進めております。

Scope3につきましても、排出量の多い製品使用時の排出量削減を中心とした取り組みを積極的に推進してまいります。



<ご参考> <https://www.towajapan.co.jp/jp/company/esgdata/#scope3>

## 認証取得

### 【「健康経営優良法人2024」に認定】

昨年に引き続き、「健康経営優良法人2024」に認定されました。今後も社員一人ひとりの健康維持・増進、ワーク・ライフ・バランスの向上に取り組み、健康経営を推進してまいります。



### 【「スポーツエールカンパニー2024」に認定】

スポーツ庁が行っている、従業員の健康増進のためにスポーツ活動の促進に積極的に取り組む企業を「スポーツエールカンパニー」として認定する制度に認定されました。今後も社員がスポーツを楽しみながら、健康的な生活を送ることができるよう環境づくりに努めてまいります。



T O W A ビ ジ ョ ン 2 0 3 2

# 「変革で世界の頂へ」



《本資料に関するお問合せ》TOWA株式会社 企画部

〒601-8105 京都市南区上鳥羽上調子町5番地 Tel : 075-692-0251

本資料には当社グループの計画や方針、財務、技術、製品、サービス、業績等に係る将来予想に関する記述が含まれております。将来予想に関する記述は、あくまで当社グループが現時点において入手可能なデータや仮定、方法等に基づき、当社グループが判断したものであり、様々なリスクや不確定な要因を含んでおります。また、新たなリスクや不確定要因は随時生じるものであり、その発生や影響を予測することは不可能であります。したがって、本資料に含まれる将来に関する記述は、実際の結果とは大きく異なる可能性があることをあらかじめご了承ください。

# 参考資料



# 会社概要

会社名	TOWA株式会社
事業内容	半導体・LED製造装置、超精密金型、 ファインプラスチック成形品、レーザ加工装置
設立	1979年4月
代表者	代表取締役社長 岡田 博和
従業員数	1,985名(連結) [2024年3月末]
資本金	89億円
証券コード	6315
所在地	京都市南区上鳥羽上調子町5番地

# 事業内容

## 新事業

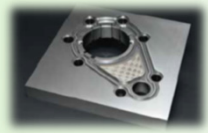
- ・ TSS (トータルソリューションサービス)
- ・ 精密加工用工具、受託加工
- ・ 微細加工
- ・ コーティング



改造・修理  
予防保全



微細加工技術



受託加工



工具 (エンドミル)

## レーザー加工装置事業

- ・ レーザトリマ
- ・ ウェハーマーカ
- ・ レーザ溶接機



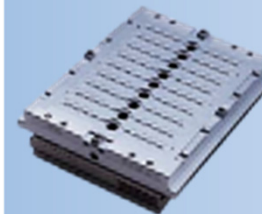
レーザートリミング装置  
SL432R



ウェハーマーキング装置  
SL473GS3

## 半導体事業

- ・ 半導体製造用精密金型
- ・ 半導体製造用モールド装置
- ・ 半導体製造用シンギュレーション装置



トランスファー金型



モールド装置  
PMC2030-D



モールド装置  
CPM1080

## 化成品事業

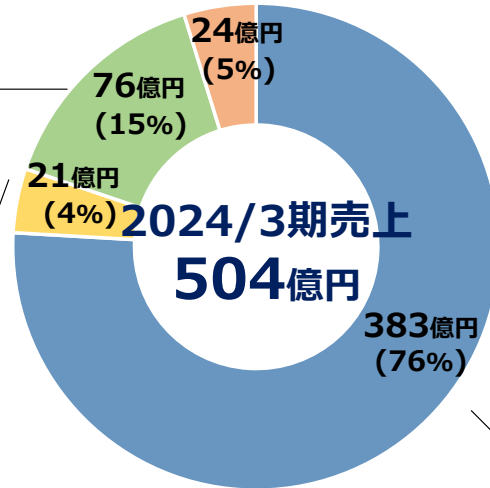
- ・ ファインプラスチック成形品
- ・ 医療機器



点滴用部品



注射器用部品





# 生産拠点

- TOWA
- グループ会社



韓国

- TOWA韓国株式会社
- TOWAファイン株式会社

半導体製造装置、精密金型、部品の製造

ブレードの製造



京都

- 本社・工場（京都市）

半導体製造装置、精密金型の開発・製造



京都

- 京都東事業所（宇治田原町）

半導体製造用金型の製造



佐賀県（鳥栖市）

- 九州事業所

半導体製造用金型の製造



中国

- TOWA半導体設備（蘇州）有限公司

半導体製造装置、精密金型の製造



- 東和半導体設備（南通）有限公司

半導体製造装置、精密金型の製造



マレーシア

- TOWAM Sdn. Bhd.
- TOWA TOOL Sdn. Bhd.

半導体製造装置の製造

半導体製造用金型の製造



日本

神奈川県（相模原市）

- TOWAレーザーフロント株式会社

レーザー及びレーザー加工装置の開発、製造



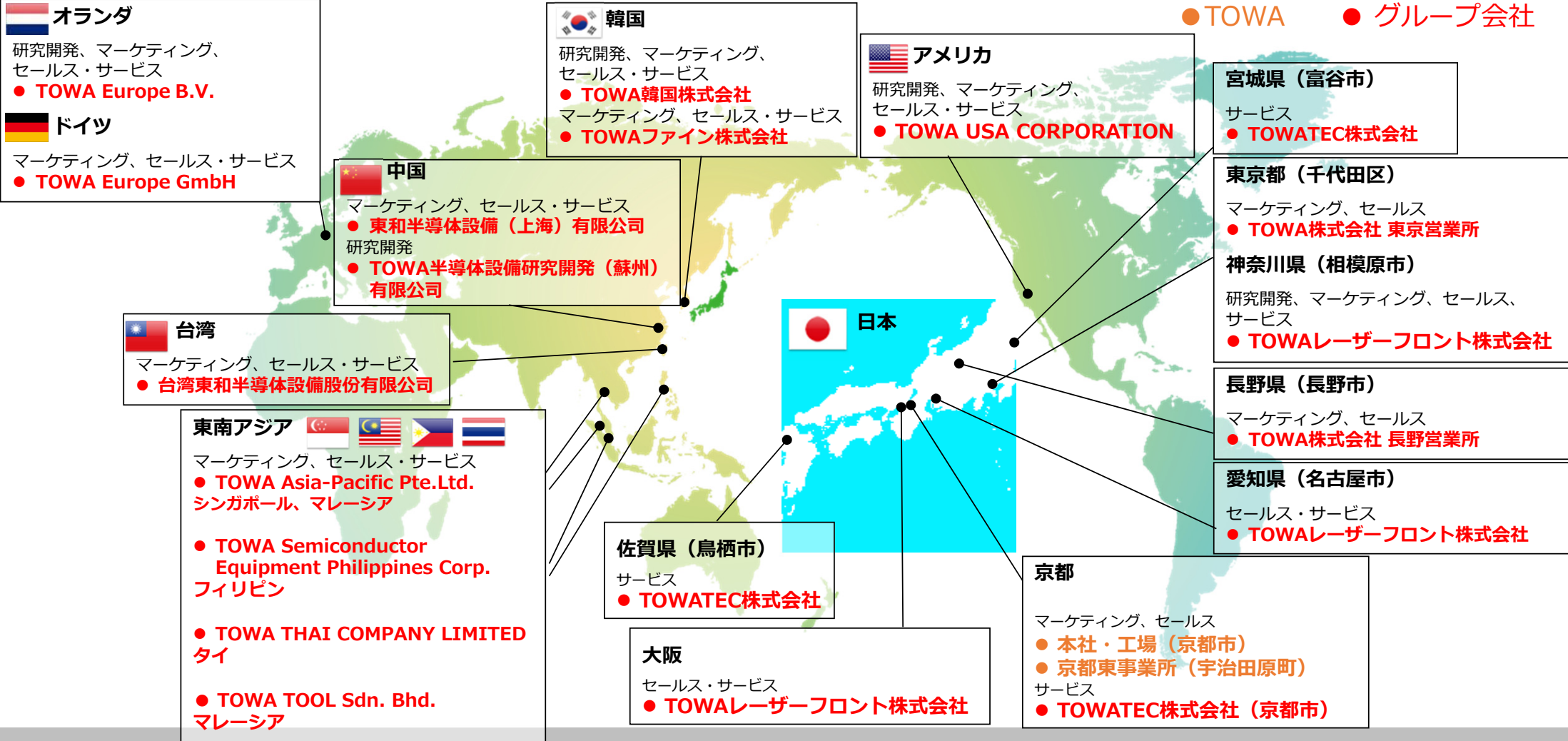
山梨県（韮崎市）

- 株式会社バンディック

ファインプラスチック成形品の製造

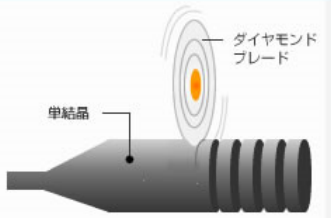
# 販売・サービス拠点

● TOWA ● グループ会社



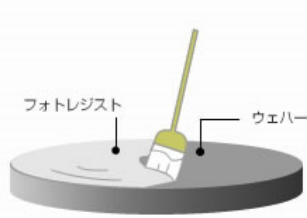
# 半導体が出来るまで - 前工程 -

## インゴットの引き上げ/切断/研磨



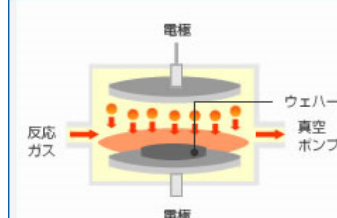
高純度シリコンの種から単結晶棒をつくります。その後、インゴットを円盤状に切断、ウエハー表面を鏡面状に研磨します。

## フォトレジスト塗布



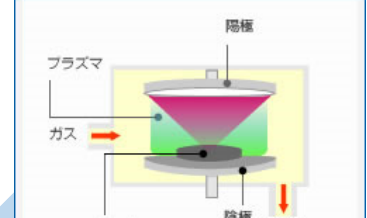
フォトレジストという感光剤を薄く塗布し、ウエハーに感光性をもたせます。

## エッチング



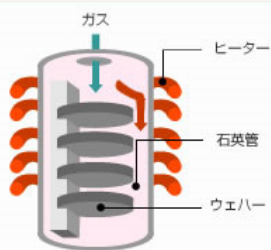
不要な部分の酸化膜およびフォトレジストを除去します。

## 電極形成



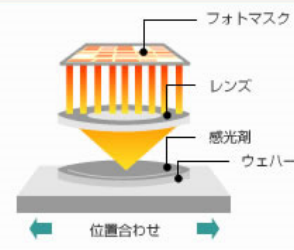
ウエハーの表面に金属膜をつくります。

## ウエハー表面を酸化



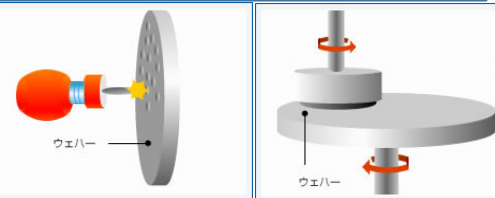
ウエハーを高温の拡散炉へ設置し、表面に酸化膜をつけます。

## パターン形成



回路設計時に製作するフォトマスクを使用し、ウエハー表面に回路のパターンを焼き付けます。

## 酸化・拡散・CVD・イオン注入



ウエハーに必要なイオンを注入し、素子をつくります。その後、表面の凹凸をなくします。

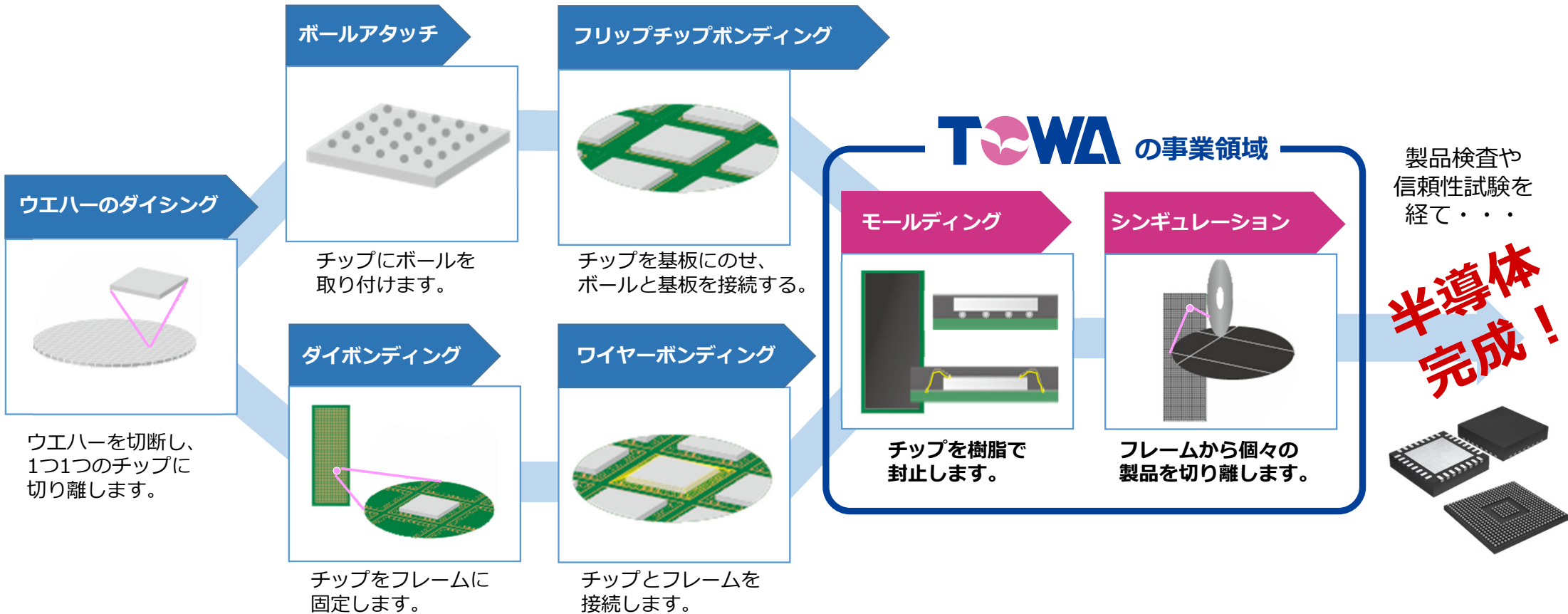
## ウエハー検査

ウエハー上の各チップを検査し、良品・不良品の確認を行います。

後工程へ

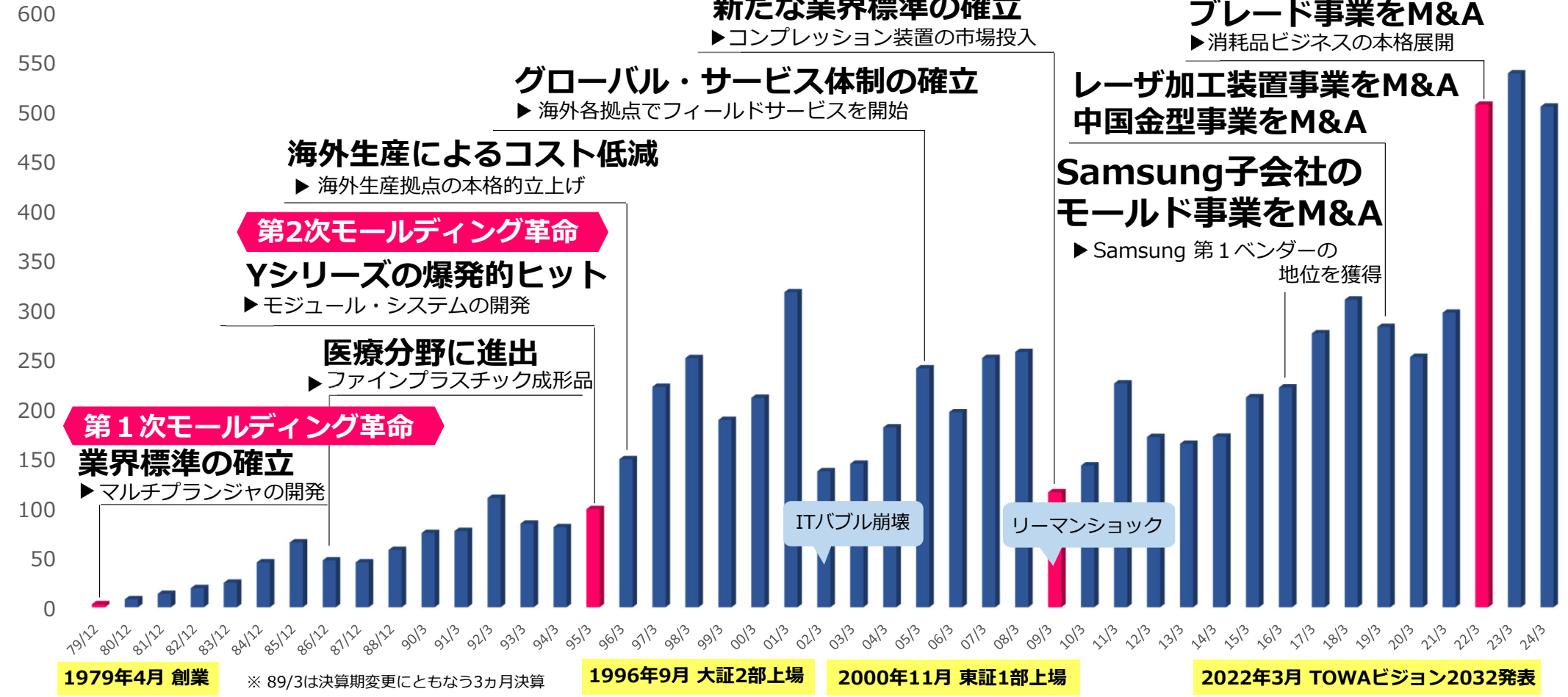


# 半導体が出来るまで - 後工程 -



# TOWAの歩み

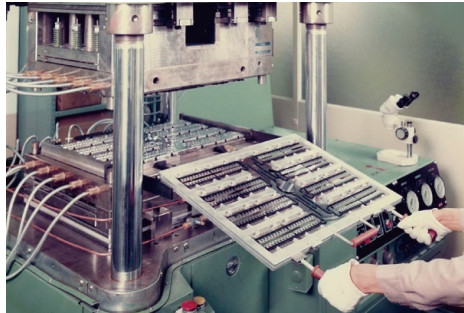
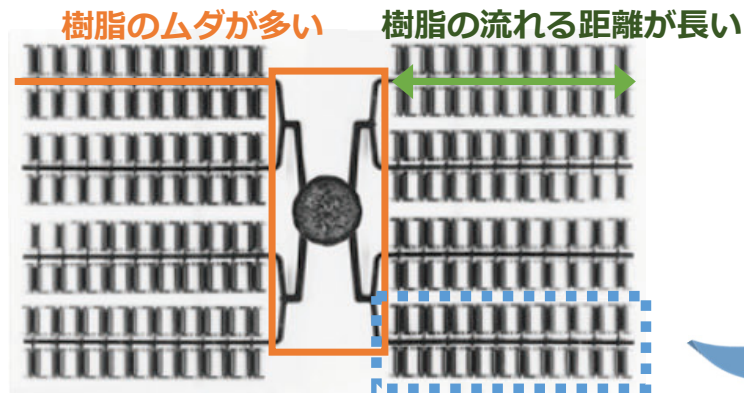
(億円)



# 第1次モールドディング革命(1979年)

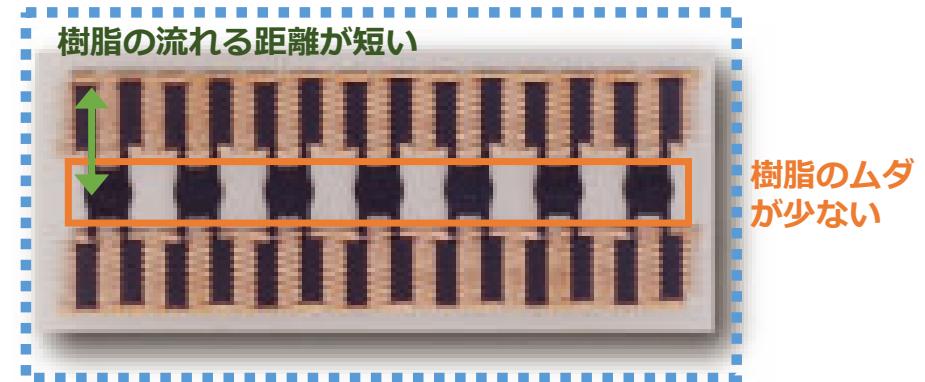
## コンベンショナルモールド

手のひらサイズの樹脂を一カ所から注入し、**手動**で成形。樹脂の流れる**距離が長く**成形品質に**バラツキ**が出来、**樹脂のムダが多い**。



## マルチプランジャモールド

指先サイズの樹脂を複数カ所から注入し、**自動**で成形。樹脂の流れる**距離が短く**成形品質が**向上**し、**樹脂のムダが少ない**。



# 第2次モールドイング革命(1995年)

## モジュールシステム (Yシリーズ)

モジュールシステム以前のモールドイング装置は・・・

- ・ 一品一様であり、生産する**製品毎に装置を買い替え**
- ・ 生産量に応じて**複数の装置を保有**する必要がある



モジュールシステムにより**プレス**の増減が可能に!!

- ・ Yシリーズだけで**様々な製品の生産が可能**
- ・ 生産量に応じて**追加で設備投資が可能**

後工程をIDMから組立専門企業が請け負う時代のニーズに合致!!

**世界に誇る半導体モールドイング装置のベストセラー**



# 第3次モールドディング革命(2009年)

## コンプレッション装置

TOWA独自のコンプレッション（圧縮）成形方式により、最先端製品の封止と大幅なコスト削減が可能に!!

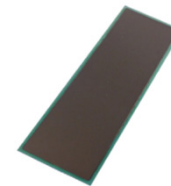
特許や技術的難易度の高さから2009年のリリース以来、現在まで他社の追隨なし。

### 特 徴

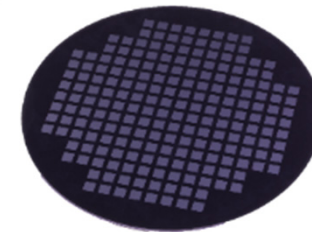
- ・樹脂使用効率**100%**（CO2排出量約**70%**削減）
- ・樹脂流動のない圧縮成形（不良品が**少ない**）
- ・メモリや5G向けなどの**最先端製品**に最適
- ・顆粒/液状樹脂の両方に対応
- ・パネルサイズ、ウェハーサイズに対応



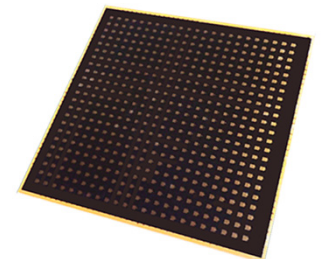
PMC2030-D



基板サイズ  
100×300mm



ウェハーサイズ  
φ300mm



パネルサイズ  
600mm×600mm

# 半導体パッケージへのソリューション

## トランスファー成形

注入方式

樹脂流動  
有

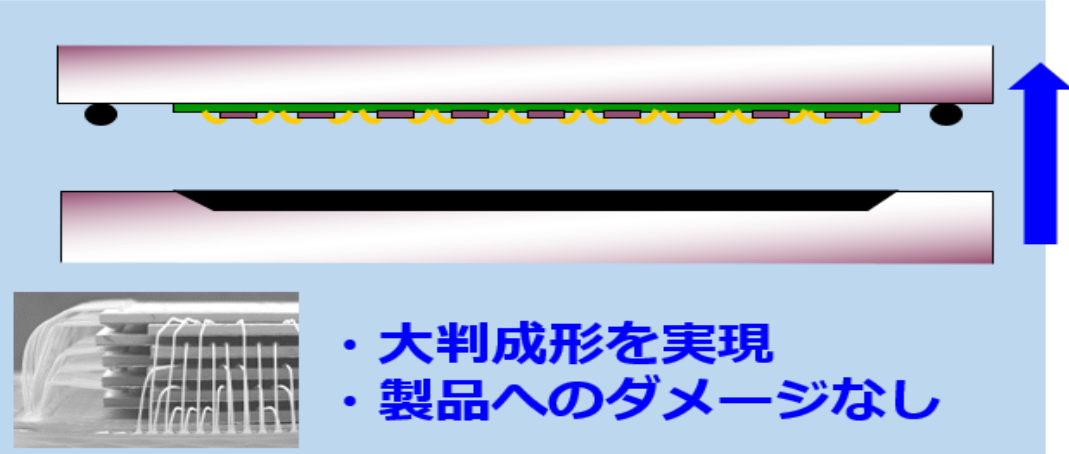
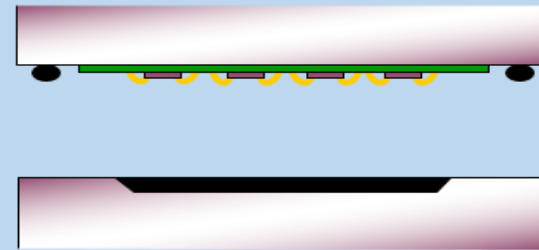


- ・未充填
- ・ワイヤダメージ発生

## コンプレッション成形

圧縮方式

樹脂流動  
無



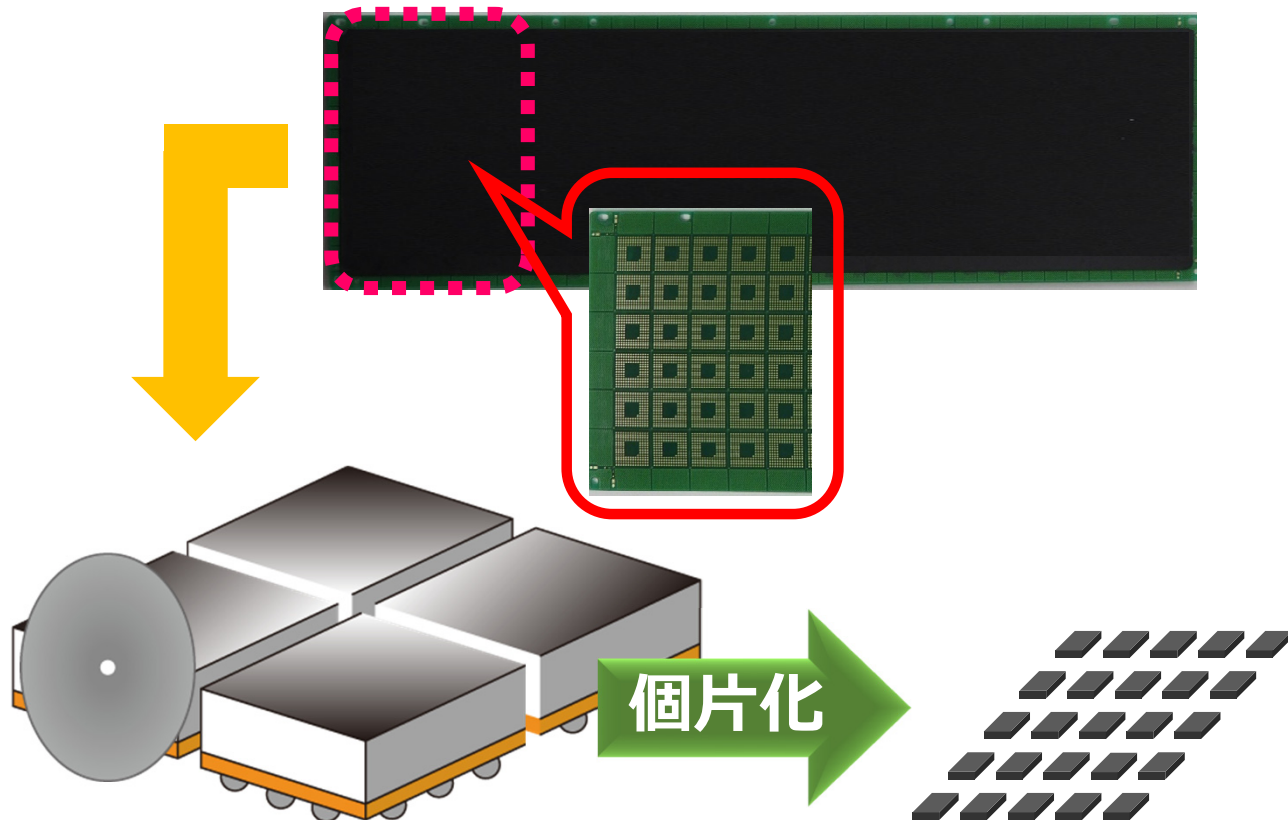
- ・大判成形を実現
- ・製品へのダメージなし



# シングルレーションプロセス

モールドディング後、1つ1つの半導体に個片化する

業界最小！  
1.0×1.0mmの  
個片化が可能



FMS4040

# 半導体製造装置ラインナップ

## ～ Compression Mold ～

### CPM 1180



Work max size : 625x620mm

### CPM 1080



Work max size : φ300mm、320x320mm

### PMC 2030-D



Work max size : 100x300mm

## ～ Transfer Mold ～

### YPM 1180



Work max size : 100x300mm

## ～ Singulation ～

### FMS4040



Work max size : 100x300mm